PASJ2019 THPI005

TESLA 型・STF 型 9 セル超伝導空洞の内面検査結果および性能測定

INNER SURFACE INSPECTIONS AND PEFORMANCES IN THE TESLA-TYPE AND STF-TYPE 9-CELL CAVITIES

石原将治^{#,A)}, 浅野峰行^{A)}, 今田信一^{A)}, 山田浩気^{A)}, 泰中俊介^{A)}, 菊池祐亮^{A)}, 梅森健成^{B)}, 片山領^{B)}, 加古永治^{B)}

Shoji Ishihara^{#,A)}, Mineyuki Asano^{A)}, Shin-ichi Imada^{A)}, Hiroki Yamada^{A)}, Shunsuke Tainaka^{A)}, Yusuke Kikuchi^{A)},

Kensei Umemori^{B)}, Ryo Katayama^{B)}, and Eiji Kako^{B)}

^{A)} Nippon Advanced Technology

B) KEK

Abstract

The inspection of inner surface in superconducting (SC) cavities and vertical tests have been carried out to confirm their cavity performances at a cryogenic temperature in the Superconducting RF Test Facility (STF) at High Energy Accelerator Research Organization (KEK). Six TESLA-type and a STF-type 9-cell SC cavities were fabricated in 2019. The results of vertical tests and the inspection of inner surface in seven 9-cell SC cavities are described in this paper.

1. はじめに

KEK の STF 棟では、超伝導加速空洞の内表面の検 査や性能評価試験であるたて測定を実施している。 STF2 加速器に内蔵するための 9 セル空洞のたて測定 が2014年に終了して以降は、高Q値・高加速電界達成 のための R&D として、窒素ドープや窒素インフュージョ ン[1]の処理をした単セル空洞の測定を主に行っている。 2019年に1台のSTF-typeと6台のTESLA-typeの合計 7 台の 9 セル空洞が製造された。STF-type の 9 セル空 洞(MHI-31)は、STF2 加速器のクライオモジュールに内 蔵されている性能が低い9セル空洞と入れ替える予定の 空洞として製造された。TESLA-type の 9 セル空洞は、 KEK の空洞製造技術の向上と中程度の RRR を使用し て製造コスト削減を目的としたラージグレイン空洞 (KEK-04,05)2 台、および、窒素インフュージョンによる 高加速電界達成の R&D を目的とした 4 台の空洞(MT-03,04,05,06)が製造された。今回の発表では、現時点で 実施された 9 セル空洞の内面検査とたて測定の結果に ついて報告する。

2. 内面検査

超伝導加速空洞の内表面の検査は、赤道とアイリス、 ビームパイプの溶接ビードとその近傍部分をカメラで撮 影して、欠陥や異常がないかを調べる[2]。Figure 1 は、 空洞受入後に100 μmの電界研磨を実施した9 セル空 洞の赤道の溶接ビードをシリーズ別に比較した。MHI-31 空洞とMT-03 空洞は、赤道溶接前に溶接開先部および 周辺部の機械加工を実施している。機械加工の目的は、 溶接時のシール面の板厚を均等にし、表面をきれいに 処理する事で欠陥の発生を防ぐ事が期待できる。KEK-04 は、赤道溶接前にセルの湾曲部分を研磨して表面を 滑らかに処理している。

Figure 2は、アイリスの溶接ビードを比較した写真を示

す。アイリス部分に欠陥等は見つからなかったが、KEK-04のアイリスは、赤道溶接前にアイリスを全周にわたって研磨を行っているために、アイリス部の溶接ビード表面の凹凸をなくしたフラットなアイリスが観測された。



Figure 1: Comparison of bead characteristics on equator between three cavities; MHI-31, MT-03 and KEK-04.



Figure 2: Comparison of bead characteristics on iris between three cavities; MHI-31, MT-03 and KEK-04.

MHI-31 空洞は、受け入れ後に 100 μm の電界研磨を 実施し、その後の内面検査で、いくつかの欠陥を発見し た。たて測定実施前に発見した欠陥の中から、4 箇所の 欠陥に対して局所研磨器[3]と手による研磨を実施した。

[#] nat-ishi@post.kek.jp

PASJ2019 THPI005

Figure 3 は、局所研磨を行った箇所の経過別の様子を 示す。粗い目の研磨シートで 60 分間研磨を実施し、欠 陥を除去した後に、細かい目の研磨シートで 390 分磨く ことで空洞内表面のざらつきをおさえ、表面を滑らかに 仕上げている。Figure 3 の左下図の研磨直後の写真で は、研磨時に十分に洗浄が出来なかったため、黒い部 分に研磨シートの砥粒が残っている。電解研磨 20 µm を 行った 1 回目のたて測定後の写真では、表面が滑らか になっており、欠陥も完全に除去出来ている。



Figure 3: Mechanical polishing of pits at equator (7th-cell 139 degree) in MHI-31.

たて測定結果

実施した9セル空洞のたて測定結果を、Table 1 に示 す。STF-type 空洞 (MHI-31) のたて測定が 3 回と TESLA-type 空洞 (KEK-04) のたて測定を 1 回実施し た。

Table 1: Result of Vertical Tests a	IT 2K
-------------------------------------	-------

cavity	type	times	E _{acc, max} [MV/m]	limiting cause
MHI-31	STF-type	1	21.3	Quench (F.E.)
MHI-31	STF-type	2	-	Input Cable broken
MHI-31	STF-type	3	30.3	Quench
KEK-04	TESLA-type	1	31.5	Quench

3.1 MHI-31 空洞のたて測定結果

MHI-31 空洞のたて測定の結果として、1 回目は、最 大加速勾配が 21.3 MV/m となった。たて測定後の内面 検査では、クエンチ箇所の欠陥を発見できず、フィール ドエミッションによるクエンチによって空洞性能が制限さ れた。1 回目のたて測定の後に、20 μm の電解研磨を 行った。それによって、空洞内表面を除去する事で、 フィールドエミッションの発生源を取り除き、2 回目のたて 測定を実施したが、冷却作業中にインプットケーブルが 損傷したために、正常な値での測定ができなかった。そ の後、インプットケーブルのみを新しいケーブルに変更 して、3 回目のたて測定を実施した。Figure 4 に MHI-31 空洞の 3 回目のたて測定の Q₀-Eacc 曲線を示す。初回 測定時の最大加速勾配は 22.0 MV/m であり、放射線が 10 MV/m から発生した。その後、各パスバンド測定を実施しており、その際にフィールドエミッションがプロセスされた。最終測定時には、放射線のオンセットが 10 MV/m から 17 MV/m に向上し、最大加速勾配も 30.3 MV/m に増加している。

Figure 5 は、空洞外面に取り付けた温度センサによる 各パスバンド測定におけるクエンチした時の発熱分布と 最大加速勾配を示す。発熱箇所周辺を内面検査時に詳 細に調べたが、発熱箇所を特定することができなかった。 過去に実施してきた内面検査においても、クエンチ時の 加速勾配が 30 MV/mを超えた場合、空洞性能を制限す る欠陥が見つからないことが多かった。

各パスバンド測定の結果から、確認できたセル毎の到 達加速電界を Table 2 に示す。全てのセルで 30 MV/m を超えている事を確認した。



Figure 4: Q_0 -E Curve (MHI-31, 3rd V.T.).



Figure 5: Heating locations detected by T-mapping system (MHI-31).

Table 2: Achieved Eacc of Each Cell in MHI-31

	1-cell &	2-cell &	3-cell &	4-cell &	5-cell
	9-cell	8-cell	7-cell	6-cell	
Eacc,max [MV/m]	36.2	30.3	35.4	35.0	38.1

3.2 KEK-04 空洞のたて測定結果

KEK-04 空洞のたて測定における Q₀-Eacc 曲線を、

PASJ2019 THPI005

Fig. 6に示す。初回測定では、12 MV/mを過ぎた後に発生したクエンチによって、Q₀値が回復し、放射線の値も減少したことが分かる。最終的に最大加速勾配は29.0 MV/m になった。その後、各パスバンド測定を実施した時に、さらにプロセスが進み、最終測定では、最大加速勾配が、31.5 MV/mまで増加した。ただし、この時クライオスタット内のHe液の残量が少なくなったことから、途中の取得データを制限し、クエンチによる最大加速勾配を確認する事を優先した。

Figure 7 は、KEK-04 空洞の各パスバンド測定のクエ ンチ時の発熱分布と最大加速勾配、内面検査で発見し た空洞性能を制限したと思われる欠陥を示す。MHI-31 空洞では、空洞性能を制限した欠陥を特定できなかった が、KEK-04 空洞では、発熱箇所と思われる欠陥を見つ けることができた。6 セルの 58 度に見つかった欠陥は、 πモードと6π/9モードで発熱があった箇所であり、約31 MV/m でクエンチしている。赤道部ビードから約 13 mm ずれた位置にあるが、その大きさが約 180 μm で形の はっきりした欠陥であるために、空洞性能を制限している 欠陥であると考えられる。7 セルの 262 度に見つかった 欠陥は、5π/9 モードで発熱があった箇所であり、約30 MV/m でクエンチしている。そのサイズが6セルの欠陥と 比べて小さく、約 40 µm であるが、溶接ビードの直近に 存在しているために、クエンチの原因になったと思われ る。他のパスバンド測定での発熱箇所は、加速勾配が約 40 MV/m と高く、特定する事が出来なかった。これらの 空洞性能を制限する欠陥を研磨して取り除ければ、さら なる空洞性能の向上に繋がっていくと思われる。

各パスバンド測定の結果から、確認できたセル毎の到 達加速電界をTable3に示す。到達加速電界は、欠陥の ために 31.5 MV/m のセルがあるが、欠陥の影響がない セルでは、40 MV/m を超えている事が確認できた。



Figure 6: Q₀-Eacc Curve (KEK-04, 1st V.T.).



Figure 7: Heating locations detected by T-mapping system and phots of the inner surface (KEK-04).

Table 3: Achieved Eacc of Each Cell in KEK-04

	1-cell &	2-cell &	3-cell &	4-cell &	5-cell
	9-cell	8-cell	7-cell	6-cell	
Eacc,max [MV/m]	40.0	41.0	31.5	31.5	41.0

4. まとめ

新しく製造した STF-typeと TESLA-type の9 セル空洞 の内面検査とたて測定を実施した。たて測定は、STFtype の MHI-31 空洞が 3 回と TESLA-type の KEK-04 空洞を1 回実施した。たて測定時に、空洞外面に取り付 けた温度センサによる発熱分布と内面検査により、KEK-04 空洞の空洞性能を制限する欠陥を特定することがで きた。たて測定を実施していない残りの 9 セル空洞は、 秋以降にたて測定を実施する予定である。

参考文献

- T. Kubo, "Physics of superconducting cavity: towards realizations of high-Q and high gradient cavities" Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Sapporo, Aug. 1-3, (2017).
- [2] Y. Iwashita *et al.*, "High resolution inspection camera for superconducting cavity" Proceedings of the 5th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Higashihiroshima, Aug. 6-8, (2008).
- [3] K. Watanabe *et al.*, "Repair techniques of superconducting cavity for improvement cavity performance at KEK-STF" Proceedings of the IPAC'10, Kyoto, (2010).